



# クールプロバイド™ / CPVP-30-F

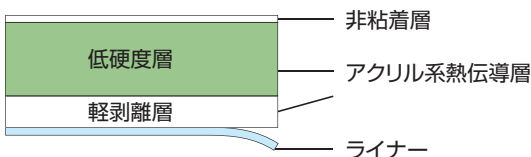
製品ページ



## シリコンフリータイプの 低硬度高熱伝導 (3W/m・K) シート

- 二層構造のためパテ状でもシートと同様に取り扱いができます。
- 熱伝導率 3.0W/m・K で、既存品より 2.1 倍性能が向上しました。
- シリコンフリータイプの為、シロキサンを含みません。
- 柔軟性、応力緩和に優れており組み込み後の発熱素子や基板への負荷を低減できます。
- 推奨使用範囲は-40 ~ 125℃です。
- シリコンタイプと比較してオイルブリードが少ないです。

### 断面図

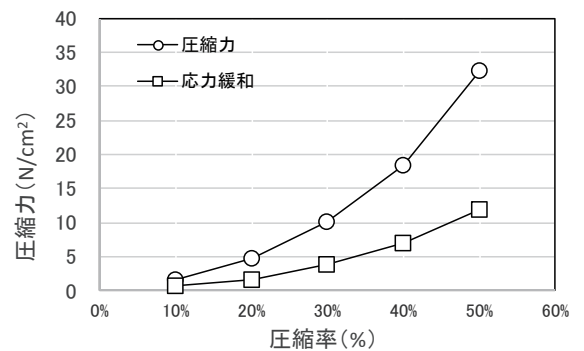


### 特性

項目	単位	準拠規格	CPVP-30-F
厚み	mm	—	1.0/1.5/2.0*1, 3.0/4.0
熱伝導率	W/m・K	ISO 22007-2 (ホットディスク法)	3.0 (低硬度層)
硬度	ASKER C	JIS K 7312	7 (低硬度層)
	Shore OO	ASTM D 2240	18(低硬度層)
体積抵抗率	Ω・cm	JIS K 6911	1.0 × 10 <sup>11</sup>
難燃性	—	UL94	V-0相当
色調	—	—	グリーン/ホワイト
推奨使用温度範囲	℃	—	-40~125

\*1 : 1.0、1.5、2.0mmは開発中です。

### ● 圧縮応力緩和特性



試料寸法 : □10mm(t=4.0mm)  
クロスヘッドスピード : 1mm/min  
圧縮板材料 上側 : ステンレス鋼 Φ28mm  
下側 : 金メッキ銅 Φ106mm

※圧縮力は、圧縮直後の最大荷重値とする。

- 仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。
- 当社の文書による事前の承諾を得ず、記載内容の転載は禁止します。